

Cajas de empalmes de resina de poliuretano líquido bicomponente para aplicaciones con voltajes medios y bajos. Compuestos por un molde, resina de poliuretano bicomponente y cinta adhesiva vulcanizable.

EC 04: Para cable de secciones hasta 4 x 4 mm².

EC 10: Para cable de secciones hasta 4 x 10 mm².

EC 25: Para cable de secciones hasta 4 x 25 mm².

Moldes en polipropileno para un mejor control de la ejecución de la obra.

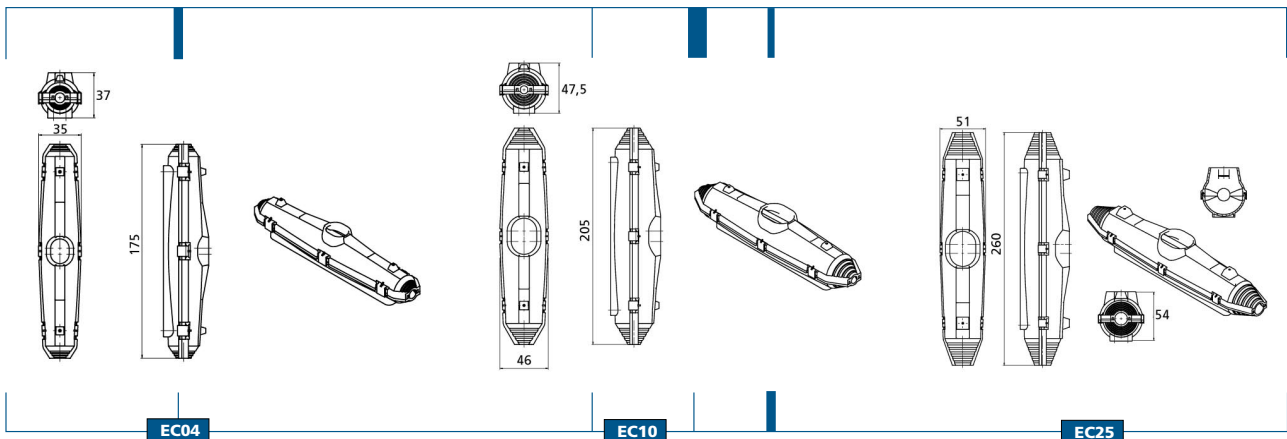
Resina de poliuretano bicomponente (poliol y isocianato) de secado rápido (10-15 min.). Recomendada para aplicaciones eléctricas por su elevado componente dieléctrico, su nula higroscopicidad y su perfecta adherencia tanto a superficies plásticas como metálicas. Ideal para el empalme de cables, se sirve envasada en recipientes separados a fin de obtener una óptima mezcla, y con un dosificador para una aplicación rápida y fácil.



EC 04, EC 10, EC 25

EC04, EC10 y EC25 son conformes a la norma UNE – EN 60335 – 1.

DIMENSIONES



COMPOSICIÓN

EC04

- Moldes de polipropileno.
- Kit resina de poliuretano líquido bicomponente (100 ml.).
- Dosificador de resina.
- 50 cm de cinta adhesiva vulcanizable.
- 4 terminales tubulares.

EC10

- Moldes de polipropileno.
- Kit resina de poliuretano líquido bicomponente (180 ml.).
- Dosificador de resina.
- 50 cm cinta adhesiva vulcanizable.

EC25

- Moldes de polipropileno.
- Kit resina de poliuretano líquido bicomponente (300 ml.).
- Dosificador de resina.
- 75 cm de cinta adhesiva vulcanizable.

CARACTERÍSTICAS RESINA

Propiedades físicas a 23°C

	Unidad	Valor
Densidad	gr/cm ³	1,51 - 1,55
Dureza	Zanca D1/D15	88 / 87
Tiempo de secado	min.	10 - 15

Propiedades térmicas de la resina

Temperatura de servicio	- 40 / + 130°C
-------------------------	----------------

Propiedades dieléctricas y de aislamiento a 23° C

Rigidez dieléctrica (50 Hz)	KV/mm	28
Constante dieléctrica (50 Hz)	KV/mm	4
Factor de disipación (50 Hz)	KV/mm	1, 10 - 2